



MSP-30T

# マグネトロンスパッタ

多目的簡易操作型マグネトロンスパッタ成膜装置

- 多目的、実験用成膜装置
- 電極分離型試料台で試料損傷回避
- 高速排気・簡易操作で能率的成膜
- 小形卓上型・小スペース
- 強磁場による多種金属成膜可能
- ターボモレキュラーポンプで清浄真空
- 低価格・コストパフォーマンスの良い機能



株式会社 真空デバイス

〒311-4155 茨城県水戸市飯島町 1285-5

Tel: 029-212-7600 Fax: 029-212-7601

E-mail: device@shinkuu.co.jp

## 特徴・仕様

### 特徴

- ★ MSP-30T は多目的、多金属、実験用イオンスパッタ成膜装置です。スパッタし易い貴金属の他、Mo,W等の重金属からTi,Al等軽金属をターゲットとし、強磁場マグネトロン方式の電極により成膜が出来ます。
- ★ マグネトロン電極は、ターゲット金属表面に沿って外周から中心方向に磁場を作りターゲット全面を有効に利用できます。
- ★ スパッタ雰囲気ガス Ar は、ターゲット電極とシールド電極の間隙よりターゲット表面に噴出させ、スパッタ効率を向上させています。
- ★ 低い電圧でコーティングすると共に試料がフローティング式なので試料損傷を小さく抑えることが出来ます。
- ★ 試料台にはシャッターを備え不安定初期スパッタ中、試料をカバーし、安定状態を確認の上、試料上への成膜を可能にしています。

### 仕様

- ターゲット : 直径 50mm ダブル磁極プレーナマグネトロン型  
静電シールド採用、水冷台取付  
顧客仕様による別途見積もり
- 成膜対象金属 : ● Au ● Ag ● Pt ● Au-Pd ● Pd  
● Cu ● Cr ● Pt-Pd ● Ni ● Fe  
● W ● Mo ● Ta ● Ti ● Al  
● ITO
- 試料ステージ : 直径 50mm、シャッター付
- ターゲットー試料間隔 : 50~100mm 可能、50, 75, 100mm 3 種標準試料台付
- チャンバーサイズ : 内径 150mm×深さ 150mm SUS チャンバー窓付
- イオン化電圧 : DC 0~600V, イオン化電流 : 0~1A 電流計読み取り
- タイマー : 0~1,2,3,12,30/sec, min, hr 各自由設定. 電子タイマー
- 排気系 : 30ℓ/sec.ターボモレキュラーポンプ、ダイヤフラムポンプ
- 真空度測定 : フルレンジ真空計、到達真空度:5E-4 Pa
- 雰囲気ガス導入 : Ar ガス、ニードルバルブ調節、電磁バルブ ON/OFF 方式
- 安全対策 : サーキットプロテクタスイッチ、及び系統別フューズ付
- 装置サイズ : 本体 440W×400D×430H (mm) 重量 40 Kg  
ダイヤフラムポンプ 170W×287L×173H (mm) 重量 6.5 Kg
- 電源 : 単層 AC 100 V, 15A アース線付3芯プラグ使用
- 水冷 : 1ℓ/min.

本カタログ記載内容は、改良に伴い予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。